



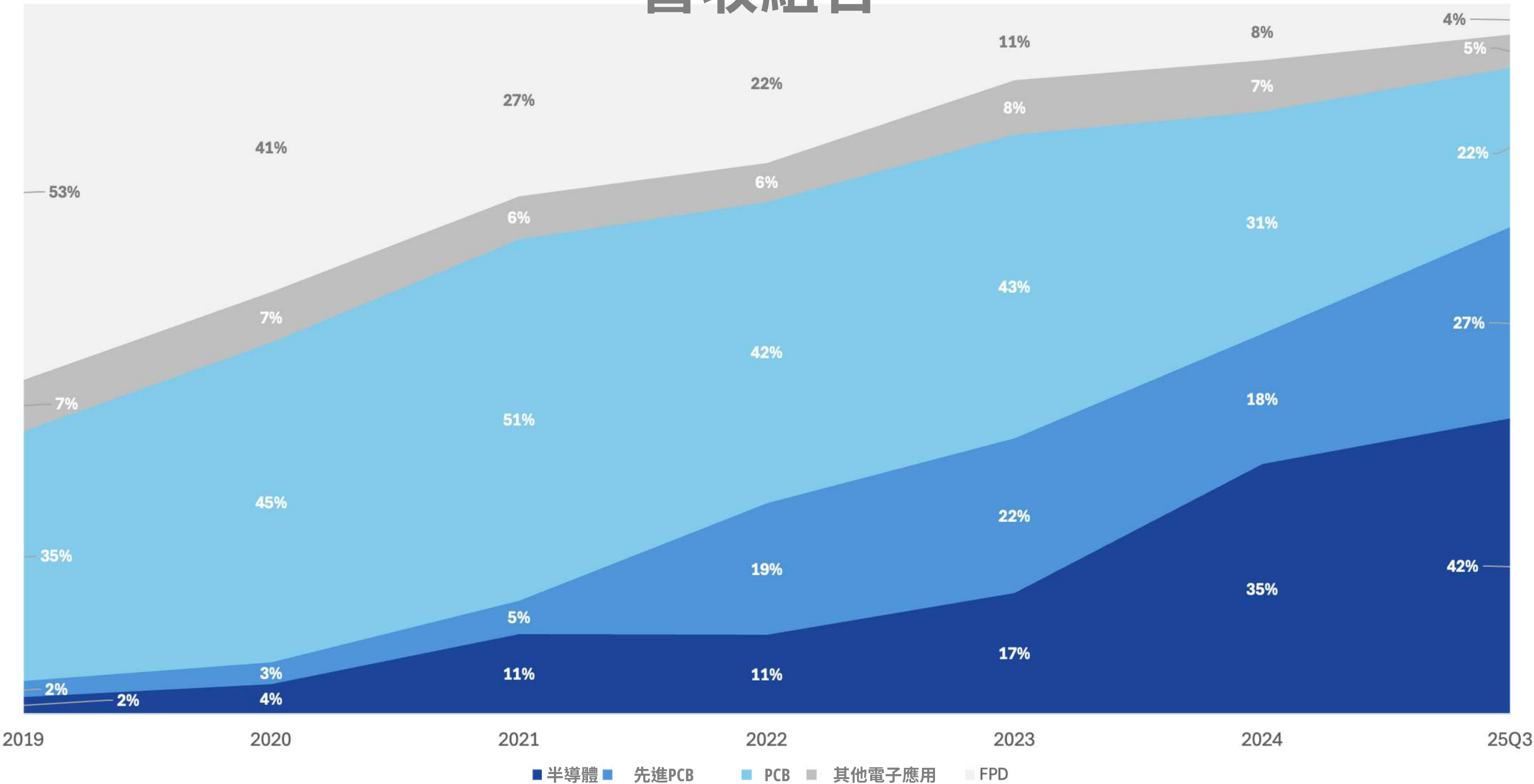
志聖工業

C SUN MFG Inc.,

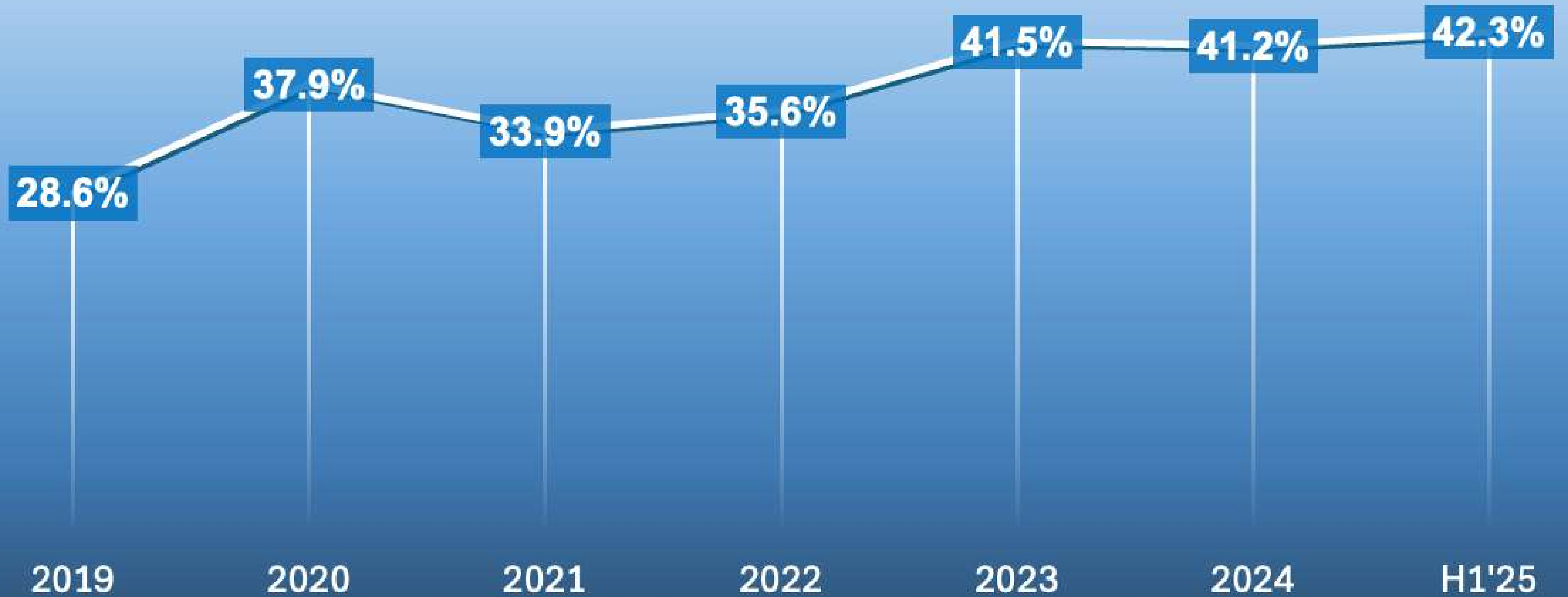
Investor Meeting, Hong Kong 2025



營收組合



毛利率



SPANNING THE AI INDUSTRY

AI CHIP HPC

IC SUBSTRATE

- Lamination
- Vacuum Lamination
- ABF Peeler

Substrate

HBM

HBM PACKAGING

- Auto Oven

ADVANCED PACKAGING

2.5D/ 3DIC

Chip-on-Wafer-on-Substrate

- Lamination
- Bonder
- Auto Oven
- UV Cure

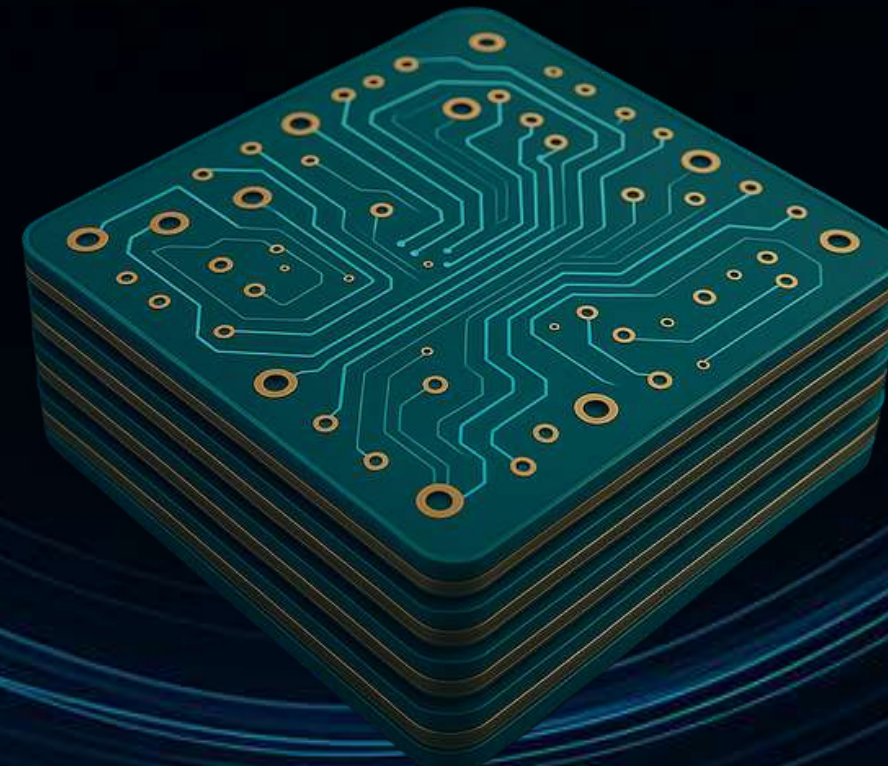


來自CPU, OAM, UBB 高密度多層板應用持續增長

自動化烤箱



水平化學錫設備



csun 志聖 **tcf** 創峰
TOP CREATION



減薄銅設備

自動化撕膜機



化學前處理設備

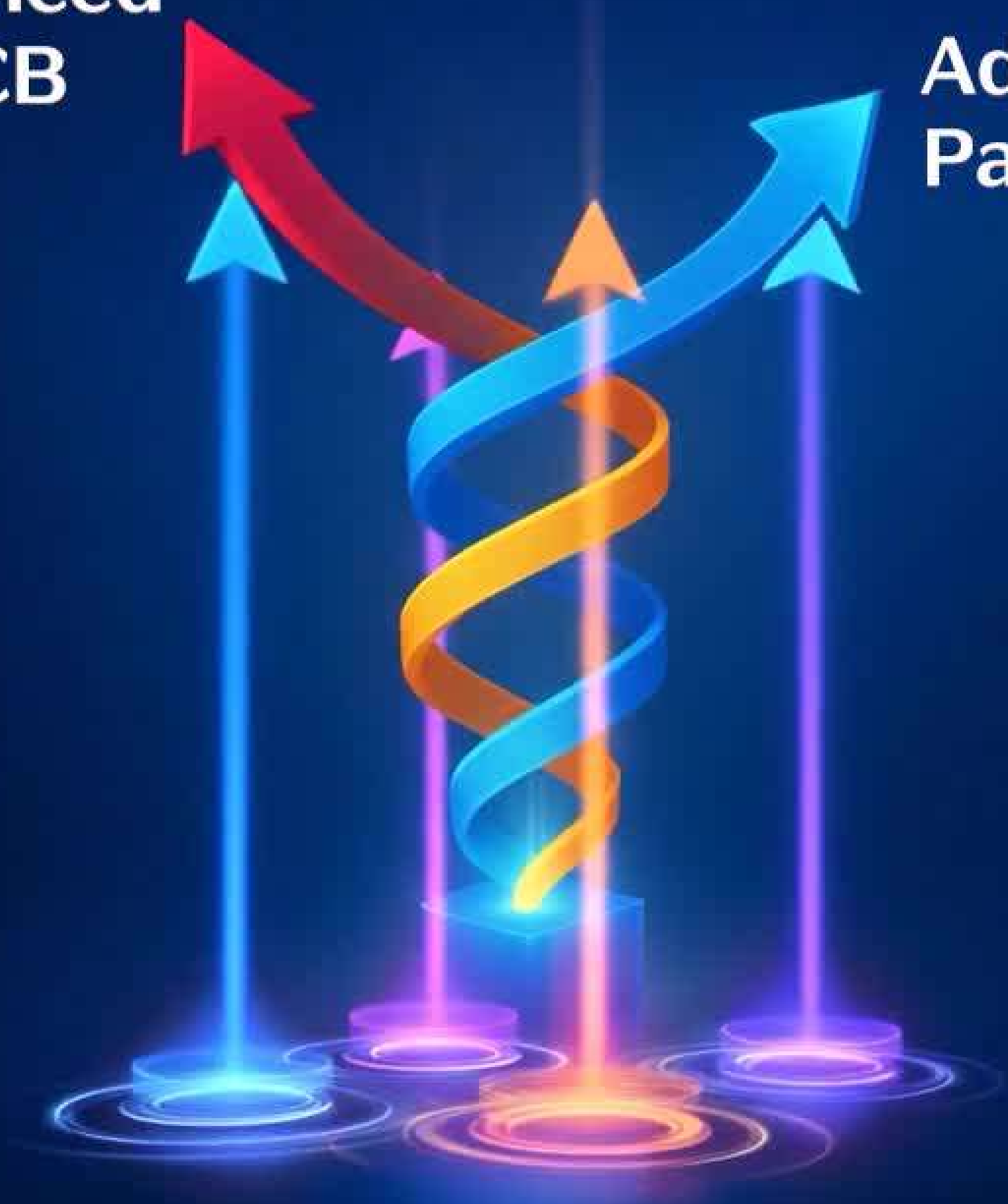


壓膜機



Advanced
PCB

Advanced
Packaging



壓、貼、撕、烤
四大核心技術
驅動半導體xPCB產業

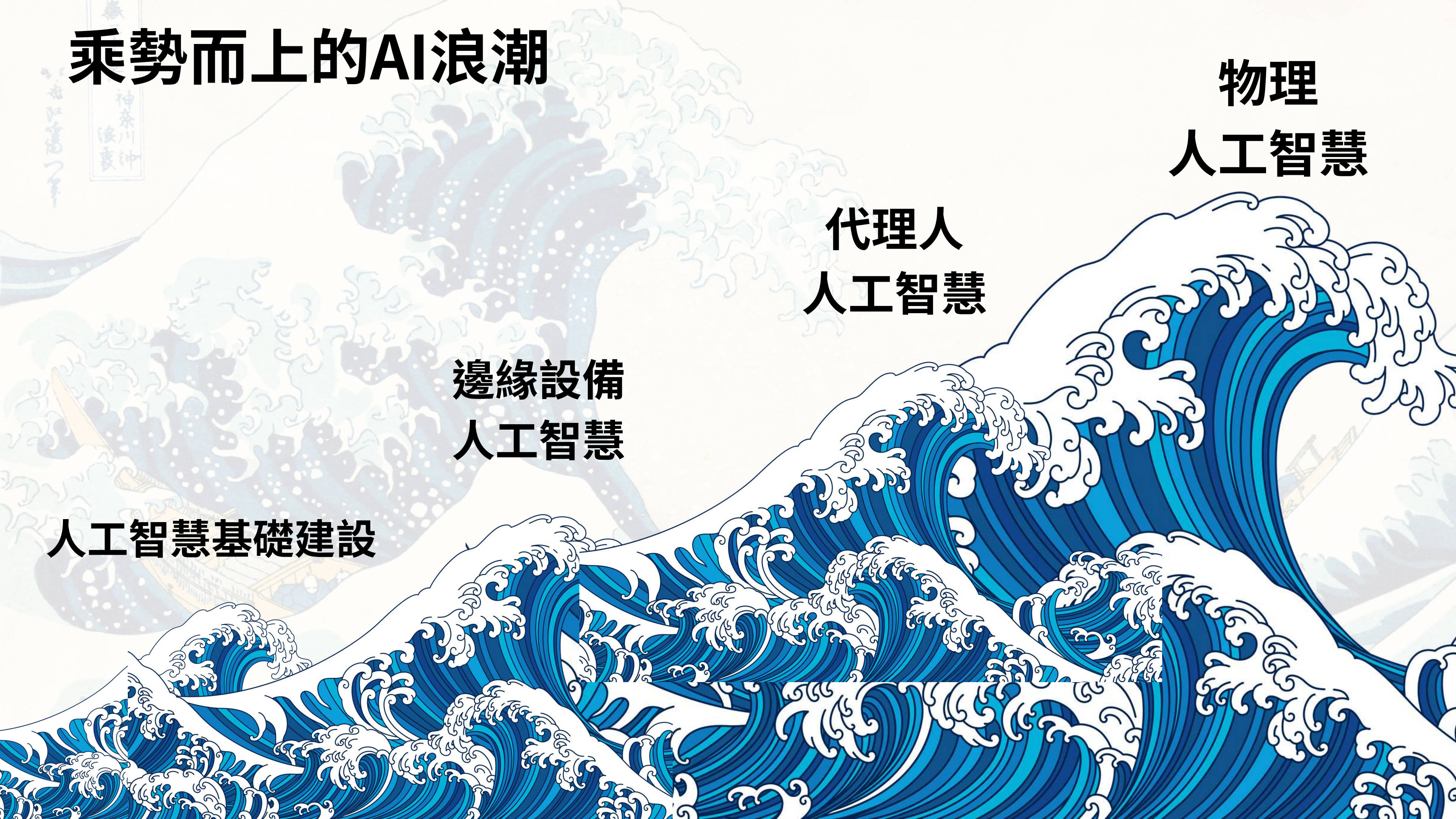
乘勢而上的AI浪潮

物理
人工智能

代理人
人工智能

邊緣設備
人工智能

人工智能基礎建設



黃仁勳執行長在AI在資本支出超級循環的觀察

I underestimated hahaha
我低估了，哈哈哈

BG²

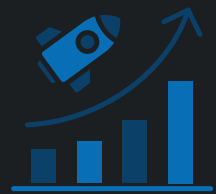
「人工智慧不再只是銷售 GPU，而是關於打造能夠生產『智慧』的 AI 工廠。」
—黃仁勳 (Jensen Huang)，NVIDIA 執行長，BG2 Podcast 專訪 (2025)



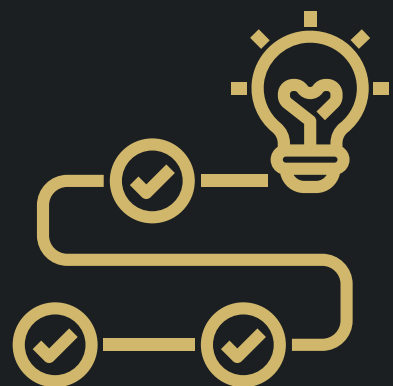
核心概念：GW中的AI工廠



投資邏輯的轉變：從「購買晶片」→「打造工廠」



**決策指標：每瓦可處理的Token數 (TpW) 取代晶片的FLOPS，
成為資本支出 (CapEx) 的關鍵績效指標。**



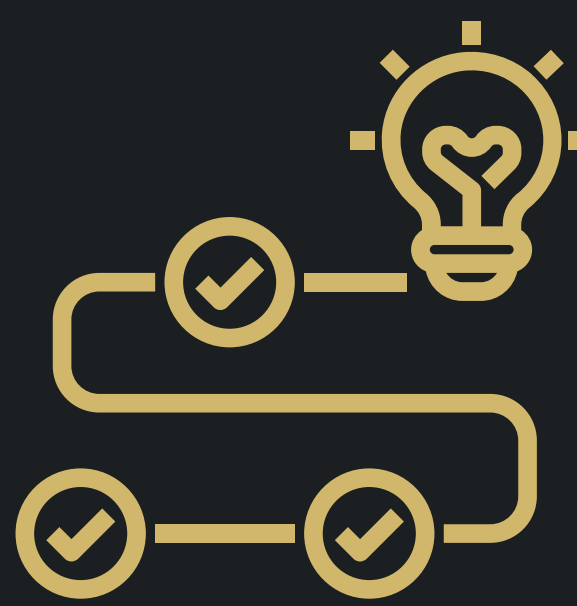
更前瞻的思考：上游供應鏈將成為 AI 產業基地的新引擎



市場動能與資本支出 (CapEx) 放大效應

到2030年，全球人工智慧基礎設施總資本支出

巴克萊銀行 (Barclays) 修正後預測：超過 2 兆美元
每 1 吉瓦 (GW) AI 能源基礎設施 $\approx$ 投資額 500 至 600 億美元
OpenAI $\times$ Nvidia 10 GW 專案 = 約 5,000~6,000 億美元
OpenAI $\times$ AMD 6 GW 專案 = 約 3,000~3,600 億美元
OpenAI $\times$ Broadcom 10 GW 專案 = 約 5,000~6,000 億美元



這將為設備投資帶來指數級的倍增效應。

更多AI工廠



更多先進封裝產能



更新、更頻繁的更新
先進封裝製程與產能



激增的設備需求



AI 工廠時代：

上游設備供應商的長期機會

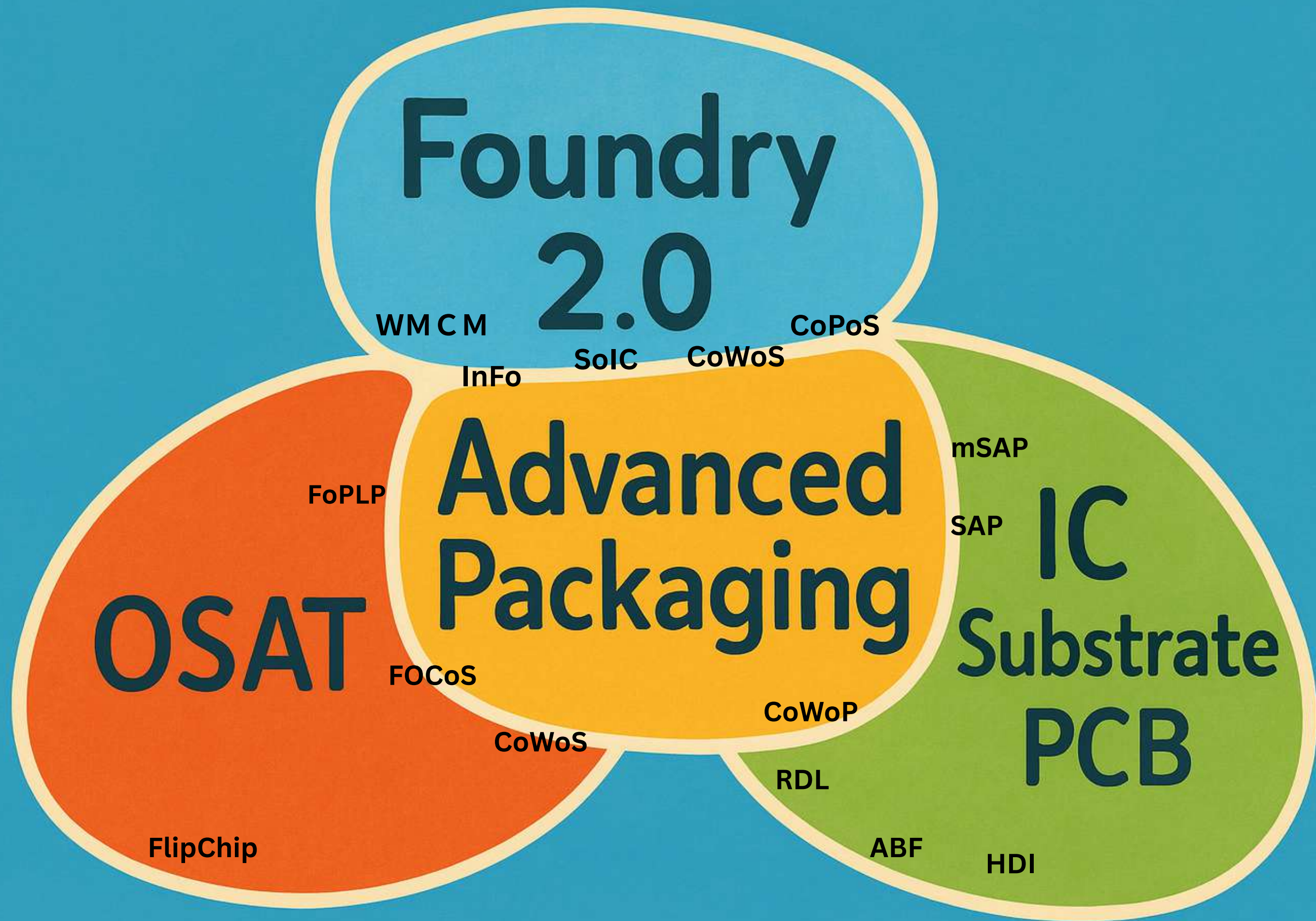
「人工智慧不再只是銷售 GPU，而是關於打造能夠生產『智慧』的 AI 工廠。」
—黃仁勳 (Jensen Huang)，NVIDIA 執行長，BG2 Podcast 專訪 (2025)



每瓦特代幣輸出
提升 2-3 倍

封裝資本支出
複合年增長率 13-17%

設備市場總額
將翻倍
長期韌性





c sun

A **G2C+** Alliance Company

Thank you for your attention
